



車載用高耐熱合金溶ダーペースト

High heat-resistant joining solder paste for automotive

開発品
Under Development

TLF-286 SERIES

特長 Features

- 高耐熱性のはんだ合金と高信頼性フラックスの両面で、信頼性を高めた溶ダーペースト
High heat-resistant solder alloy and high reliability flux make the solder paste higher reliability.

製品コンセプト Product concept

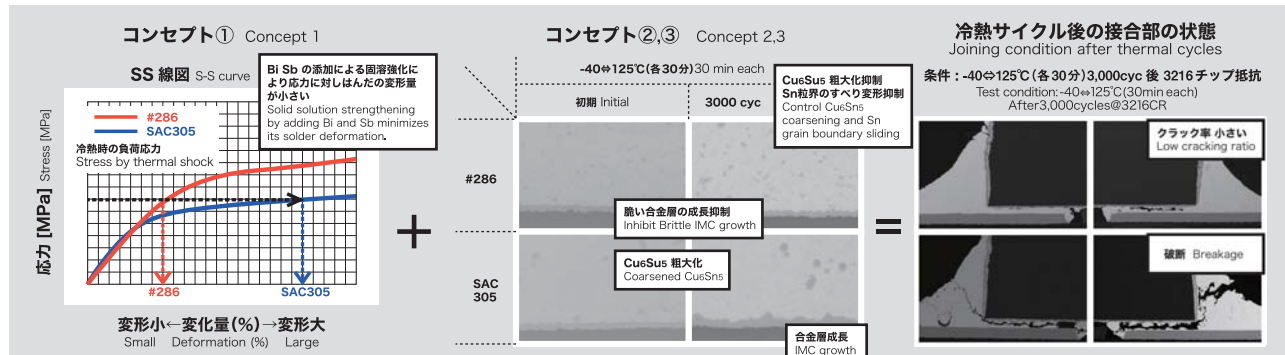
従来のSAC305に対して、下記①～③の設計コンセプトを盛り込み、冷熱サイクル時のクラック率を抑制
Inhibit crack occurrence during thermal cycles, based on the following 3 concepts

- ① 冷熱サイクル時の応力に対して、はんだの変形を抑制 Control solder deformation against the stress during thermal cycles
- ② フィレット中の Cu₆Sn₅ の粗大化を抑制 Control Cu₆Sn₅ coarsening in the fillet
- ③ 合金層の成長を抑制 Control IMC coarsening in the layer

製品概要 Product outline

はんだ合金組成 Alloy composition	Sn-Ag-Cu-Bi-Sb-α
融点 Melting point	209-224°C
リフロープロファイル Reflow profile	SAC305プロファイル Profile
リフロー雰囲気 Reflow atmosphere	N ₂ 1000ppm以下

高耐熱合金の特長 The features of High heat-resistant solder alloy



耐フラックス残さ亀裂対応、車載用次世代ペースト

Crack-free flux residue next generation solder paste for automotive

開発品
Under Development

TLF-204-GTS-VR SERIES

特長 Features

- フラックス残さの耐亀裂性と作業性を大幅に向上させた、次世代高信頼性の溶ダーペースト
This is the next generation high reliability solder paste whose anti-cracking performance of flux residue and process-ability was improved significantly.

製品コンセプト Product concept

より高い信頼性の求められる車載製品に対応し、ペーストの特性を向上させる
Improve solder paste properties for high reliable automotive devices

- 冷熱サイクル時のフラックス残さの耐亀裂性向上 Improve ability of anti-cracking during thermal cycle
- マスク厚を維持したままでの、微細開口部への印刷性の向上 Improve printability with the same stencil thickness
- ボイド面積率の低減 Decreasing void area ratio

製品概要 Product outline

はんだ合金組成 Alloy composition	Sn-3Ag-0.5Cu
融点 Melting point	216-221°C
リフロープロファイル Reflow profile	SAC305プロファイル Profile
リフロー雰囲気 Reflow atmosphere	N ₂ 1000ppm以下

特長 Features

